

2020年中国半导体分立器件行业分析报告- 产业规模现状与投资前景预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国半导体分立器件行业分析报告-产业规模现状与投资前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/485291485291.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章 半导体分立器件制造行业发展综述

1.1 行业定义及产品分类

1.1.1 半导体分立器件制造行业定义

1.1.2 半导体分立器件制造行业产品分类

1.2 行业政策环境分析

1.2.1 行业相关政策分析

1.2.2 行业相关发展规划

1.3 行业经济环境分析

1.3.1 宏观经济与行业的相关性分析

(1) GDP与行业的相关性分析

(2) 工业增加值与行业的相关性分析

(3) 固定资产投资与行业的相关性分析

1.3.2 宏观经济发展展望

1.4 行业技术环境分析

1.4.1 行业专利申请数分析

1.4.2 行业专利公开数量变化情况

1.4.3 行业专利申请人分析

1.4.4 行业热门技术分析

第二章 半导体分立器件制造行业原材料市场分析

2.1 行业产业链简介

2.2 行业原材料市场分析

2.2.1 芯片市场发展情况分析

(1) 芯片供应量分析

(2) 芯片价格走势分析

2.2.2 金属硅市场发展情况分析

(1) 金属硅产量分析

(2) 金属硅消费量分析

(3) 金属硅出口量分析

(4) 金属硅价格变动情况

2.2.3 铜材市场发展情况分析

- (1) 铜材产量分析
- (2) 铜表观消费量分析
- (3) 铜材进出口分析
- (4) 铜价格变动情况

2.3 原材料对行业的影响

第三章 半导体分立器件制造行业现状及预测

3.1 半导体分立器件制造行业经营情况分析

3.1.1 半导体分立器件制造行业发展总体概况

3.1.2 半导体分立器件制造行业发展主要特点

3.1.3 半导体分立器件制造行业市场规模分析

3.1.4 半导体分立器件制造行业财务指标分析

- (1) 半导体分立器件制造行业盈利能力分析
- (2) 半导体分立器件制造行业运营能力分析
- (3) 半导体分立器件制造行业偿债能力分析
- (4) 半导体分立器件制造行业发展能力分析

3.2 半导体分立器件制造行业供需平衡分析

3.2.1 全国半导体分立器件制造行业供给情况分析

- (1) 全国半导体分立器件制造行业总产值分析
- (2) 全国半导体分立器件制造行业产成品分析

3.2.2 全国半导体分立器件制造行业需求情况分析

- (1) 全国半导体分立器件制造行业销售产值分析
- (2) 全国半导体分立器件制造行业销售收入分析

3.2.3 全国半导体分立器件制造行业产销率分析

3.3 半导体分立器件制造行业进出口市场分析

3.3.1 半导体分立器件制造行业进出口状况综述

3.3.2 半导体分立器件制造行业出口产品结构

3.3.3 半导体分立器件制造行业进口产品结构

3.3.4 半导体分立器件制造行业进出口前景及建议

- (1) 半导体分立器件制造行业出口前景及建议
- (2) 半导体分立器件制造行业进口前景及建议

3.4 2021-2026年半导体分立器件制造行业发展前景预测

3.4.1 半导体分立器件制造行业发展的驱动因素

3.4.2 半导体分立器件制造行业发展的障碍因素

3.4.3 半导体分立器件制造行业发展趋势分析

3.4.4 2021-2026年半导体分立器件制造行业前景预测

第四章 半导体分立器件制造行业竞争格局分析

4.1 行业总体竞争状况分析

4.2 行业国际市场竞争状况分析

4.2.1 国际半导体分立器件市场发展状况

4.2.2 国际半导体分立器件市场竞争格局

4.2.3 国际半导体分立器件市场发展趋势

4.2.4 跨国公司在投资布局

(1) 日本厂商在华投资布局分析

1) 东芝 (TOSHIBA)

2) 瑞萨电子 (RENESAS)

3) 罗姆 (Rohm)

4) 松下 (Panasonic)

5) 日本电气股份有限公司 (NEC)

6) 富士电机 (Fuji Electric)

7) 三洋 (Sanyo)

8) 新电元 (Shindengen Electric)

9) 富士通 (Fujitsu)

(2) 美国厂商在华投资布局分析

1) 威旭 (Vishay)

2) 飞兆半导体 (Fairchild Semiconductors)

3) 国际整流器公司 (International Rectifier)

4) 安森美 (On Semiconductors)

(3) 欧洲厂商在华投资布局分析

1) 飞利浦半导体 (Philips Semiconductors)

2) 意法半导体 (ST Microelectronics)

3) 英飞凌 (Infineon Technologies)

4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析

4.3 行业国内市场竞争状况分析

4.3.1 行业国内市场五力模式分析

(1) 现有竞争者分析

(2) 潜在进入者威胁

(3) 供应商议价能力分析

(4) 购买商议价能力分析

(5) 替代品威胁分析

(6) 竞争情况总结

第五章 半导体分立器件应用市场发展情况分析

5.1 半导体分立器件产品概况

5.1.1 行业产品结构特征分析

5.1.2 半导体分立器件产量分析

5.2 半导体分立器件应用市场分析

5.2.1 电子设备制造对半导体分立器件需求分析

(1) 电子设备制造业发展现状

(2) 电子设备对半导体分立器件的需求

5.2.2 LED显示屏对半导体分立器件需求分析

(1) LED显示屏行业发展现状

(2) LED显示屏对半导体分立器件的需求

5.2.3 电子照明对半导体分立器件需求分析

(1) 电子照明行业发展现状

(2) 电子照明对半导体分立器件的需求

5.2.4 汽车电子对半导体分立器件需求分析

(1) 汽车电子行业发展现状

(2) 汽车电子对半导体分立器件的需求

第六章 半导体分立器件制造行业重点区域市场分析

6.1 行业区域市场总体发展状况

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.2 行业重点区域经营情况分析

6.2.1 华北地区半导体分立器件制造行业经营情况

(1) 北京市半导体分立器件制造行业经营情况

(2) 天津市半导体分立器件制造行业经营情况

(3) 河北省半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.2 东北地区半导体分立器件制造行业经营情况

(1) 辽宁省半导体分立器件制造行业经营情况

(2) 吉林省半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.3 华东地区半导体分立器件制造行业经营情况

(1) 上海市半导体分立器件制造行业经营情况

- (2) 江苏省半导体分立器件制造行业经营情况
- (3) 浙江省半导体分立器件制造行业经营情况
- (4) 山东省半导体分立器件制造行业经营情况
- (5) 安徽省半导体分立器件制造行业经营情况
- (6) 江西省半导体分立器件制造行业经营情况
- (7) 福建省半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.4 华中地区半导体分立器件制造行业经营情况

- (1) 湖北省半导体分立器件制造行业经营情况
- (2) 湖南省半导体分立器件制造行业经营情况
- (3) 河南省半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.5 华南地区半导体分立器件制造行业经营情况

- (1) 广东省半导体分立器件制造行业经营情况
- (2) 广西半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.6 其他地区半导体分立器件制造行业经营情况

- (1) 四川省半导体分立器件制造行业经营情况
- (2) 贵州省半导体分立器件制造行业经营情况
- (3) 陕西省半导体分立器件制造行业经营情况

第七章 半导体分立器件制造领先企业生产经营分析

7.1 半导体分立器件制造企业概况

7.2 半导体分立器件制造行业领先企业个案分析

7.2.1 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业产品服务分析
- (3) 企业发展现状分析
- (4) 企业竞争优势分析

7.2.2 上海松下半导体有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业产品服务分析
- (3) 企业发展现状分析
- (4) 企业竞争优势分析

7.2.3 苏州松下半导体有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业产品服务分析
- (3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.4 无锡华润华晶微电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.5 安世半导体(中国)有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.6 通用半导体(中国)有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.7 英飞凌科技(无锡)有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.8 乐山无线电股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.9 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.10 上海凯虹科技电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.11 汕尾德昌电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.12 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.13 新义半导体(苏州)有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.14 威旭半导体(上海)有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.15 吉林华微电子股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.16 深圳南山安森美半导体有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.17 扬州扬杰电子科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

7.2.18 杭州士兰微电子股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业发展现状分析

(4) 企业竞争优势分析

第八章 半导体分立器件制造行业投资分析与建议

8.1 半导体分立器件制造行业投资特性分析

8.1.1 半导体分立器件制造行业进入壁垒分析

8.1.2 半导体分立器件制造行业盈利模式分析

8.1.3 半导体分立器件制造行业盈利因素分析

8.2 半导体分立器件制造行业投资兼并分析

8.2.1 行业投资兼并与重组整合概况

8.2.2 国内企业投资兼并与重组整合

8.2.3 行业投资兼并与重组整合趋势

8.3 半导体分立器件制造行业投资机会与建议

8.3.1 半导体分立器件制造行业投资风险

8.3.2 半导体分立器件制造行业投资机会

8.3.3 半导体分立器件制造行业投资建议

图表目录

图表1：半导体分立器件制造行业主要产品类别

图表2：20项电子行业标准编号、名称、主要内容

图表3：《中国电子元件“十三五”规划》主要内容

图表4：2017-2020年GDP增长情况（单位：亿元，%）

图表5：2017-2020年中国GDP与半导体分立器件制造行业关联性对比图（单位：%）

图表6：2017-2020年全国工业增加值及其增速（单位：亿元）

图表7：2017-2020年中国工业增加值与半导体分立器件制造行业关联性对比图（单位：%）

图表8：2017-2020年全社会固定资产投资同比增速（单位：亿元，%）

图表9：2017-2020年固定资产投资与半导体分立器件制造行业关联性对比图（单位：%）

图表10：2020年中国经济预测（单位：%）

图表11：2017-2020年我国半导体分立器件的发明专利申请数量变化图（单位：项）

图表12：2017-2020年我国半导体分立器件发明专利公开数量变化图（单位：项）

图表13：截至2020年我国半导体分立器件的发明专利申请人构成图（单位：项）

图表14：截至2020年我国半导体分立器件的公开发明专利分布领域（单位：项）

图表15：半导体分立器件制造行业产业链简图

图表16：2017-2020年中国LED芯片产值规模走势图（单位：亿元，%）

图表17：2017-2020年华强北芯片价格指数变动情况

图表18：2020年我国金属硅产量靠前企业年产量对比表（单位：吨）

图表19：2020年我国金属硅出口量与出口价格走势图（单位：吨，美元/吨）

图表20：2020年金属硅出口分布（单位：%）

图表详见报告正文 （GYSYL）

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国半导体分立器件行业分析报告-产业规模现状与投资前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、阿里巴巴、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/485291485291.html>